

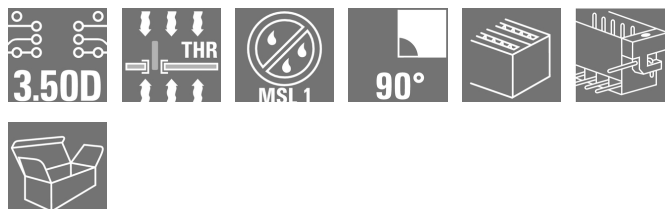
S2C-SMT 3.50/16/90LF 3.2AU BK BX SO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Термостойкий вилочный соединитель

- Система защиты пальцев
- Может подключаться к гнездовому разъёму B2CF 3.50 PUSH IN

- **Вставляется перпендикулярно или параллельно по направлению к печатной плате (180° / 90°)**

-

Варианты исполнения корпуса: закрытые (G) и с фланцем под пайку (LF)

- **Упаковка – коробка (BX) или антистатическая лента на бобине (RL)**

-

Подходит для пайки расплавлением полуды и волной припоя

- Длина штырькового вывода 1,5 или 3,2 мм

Основные данные для заказа

Исполнение	Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, 3.50 мм, Количество полюсов: 16, 90°, Длина контактного штифта (l): 1.5 mm, Au (золото), черный, Ящик
Номер для заказа	2539150000
Тип	S2C-SMT 3.50/16/90LF 3.2AU BK BX SO
GTIN (EAN)	4050118550818
Кол.	48 Шт.
Продуктное отношение	IEC: 200 V / 13.4 A UL: 150 V / 10 A
Упаковка	Ящик

S2C-SMT 3.50/16/90LF 3.2AU BK BX SO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	12,3 мм	Высота (в дюймах)	0,484 inch
Высота, мин.	10,8 мм	Глубина	14,2 мм
Глубина (дюймов)	0,559 inch	Масса нетто	7,271 g
Ширина	35 мм	Ширина (в дюймах)	1,378 inch

Упаковка

Упаковка	Ящик	Длина VPE	338 мм
VPE с	130 мм	Высота VPE	20 мм

Системные характеристики

Серия изделия	OMNIMATE Signal — серия B2C/S2C 3.50, 2-рядные	Вид соединения	Соединение с платой
Монтаж на печатной плате	Соединение THT/THR под пайку	Шаг в мм (P)	3,5 мм
Шаг в дюймах (P)	0,138 inch	Угол вывода	90°
Количество полюсов	16	Количество контактных штырьков на полюс	1
Длина контактного штифта (l)	1,5 мм	Размеры выводов под пайку	d = 1,0 mm, восьмиугольный
Диаметр монтажного отверстия (D)	1,3 мм	Допуск на диаметр монтажного отверстия (D)	+ 0,1 мм
Наружный диаметр площадки под пайку	2,1 мм	Диаметр отверстия трафарета	1,9 мм
L1 в мм	24,5 мм	L1 в дюймах	0,965 inch
Количество рядов	1	Количество полюсных рядов	2
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106	touch-safe on connector face, safe to back of hand above the printed circuit board	Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470	IP 20
Кодируемый	Да	Усилие вставки на полюс, макс.	3,5 N
Усилие вытягивания на полюс, макс.	2,5 N		

Данные о материалах

Изоляционный материал	LCP GF	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIb
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	≥ 175	Moisture Level (MSL)	1
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал контакта	Медный сплав
Поверхность контакта	Au (золото)	Температура хранения, мин.	-40 °C
Температура хранения, макс.	70 °C	Рабочая температура, мин.	-50 °C
Рабочая температура, макс.	120 °C	Температурный диапазон монтажа, мин.	-40 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.	120 °C		

S2C-SMT 3.50/16/90LF 3.2AU BK BX SO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Номинальные характеристики по IEC**

пройдены испытания по стандарту

IEC 60664-1, IEC 61984

Номинальный ток, мин. кол-во
контактов (T_u = 40 °C)

12 A

Номинальное импульсное напряжение
при категории помехозащищенности/
Категория загрязнения II/2

160 V

Номинальное импульсное напряжение
при категории помехозащищенности/
Категория загрязнения II/2

2,5 kV

Номинальное импульсное напряжение
при категории помехозащищенности/
Категория загрязнения III/3

2,5 kV

Номинальный ток, мин. кол-во
контактов (T_u = 20 °C)

13,4 A

Номинальное импульсное напряжение
при категории помехозащищенности/
Категория загрязнения II/2

200 V

Номинальное импульсное напряжение
при категории помехозащищенности/
Категория загрязнения III/3

80 V

Номинальное импульсное напряжение
при категории помехозащищенности/
Категория загрязнения III/2

2,5 kV

Устойчивость к воздействию
кратковременного тока

3 x 1 сек. с 80 A

Номинальные характеристики по CSAНоминальное напряжение (группа
использования B/CSA)

150 V

Номинальное напряжение (группа
использования D/CSA)

150 V

Номинальный ток (группа
использования C/CSA)

9,5 A

Номинальное напряжение (группа
использования C/CSA)

50 V

Номинальный ток (группа
использования B/CSA)

9,5 A

Номинальный ток (группа
использования D/CSA)

9,5 A

Номинальные характеристики по UL 1059

Институт (cURus)



Сертификат № (cURus)

E60693

Номинальное напряжение (группа
использования B/UL 1059)

150 V

Номинальный ток (группа
использования B/UL 1059)

10 A

Ссылка на утвержденные значения

В технических
характеристиках
приведены максимальные
значения, подробные
сведения см. в
сертификате об
утверждении.Номинальное напряжение (группа
использования C/UL 1059)

50 V

Номинальный ток (группа
использования C/UL 1059)

10 A

Классификации

ETIM 6.0

EC002637

ETIM 7.0

EC002637

ECLASS 9.0

27-44-04-02

ECLASS 9.1

27-44-04-02

ECLASS 10.0

27-44-04-02

ECLASS 11.0

27-46-02-01

Важное примечание

Соответствие IPC

Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.

Примечания

• Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и средней влажности 70%, 36 месяцев

S2C-SMT 3.50/16/90LF 3.2AU BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search

E60693

Загрузки

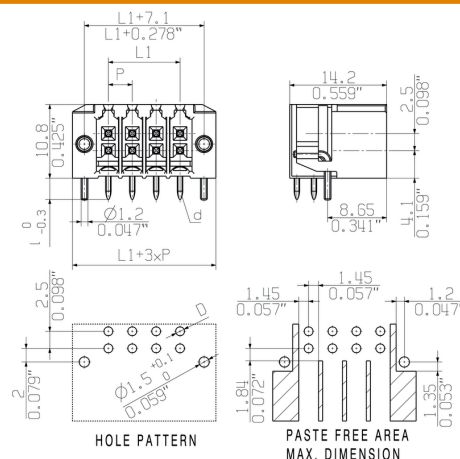
Брошюра/каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

S2C-SMT 3.50/16/90LF 3.2AU BK BX SO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

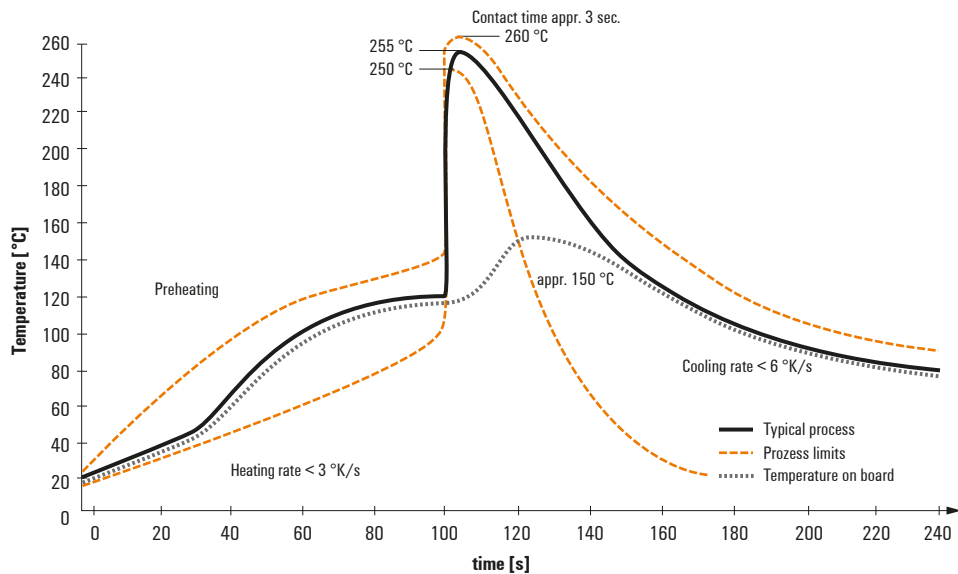
www.weidmueller.com

Изображения
Dimensional drawing


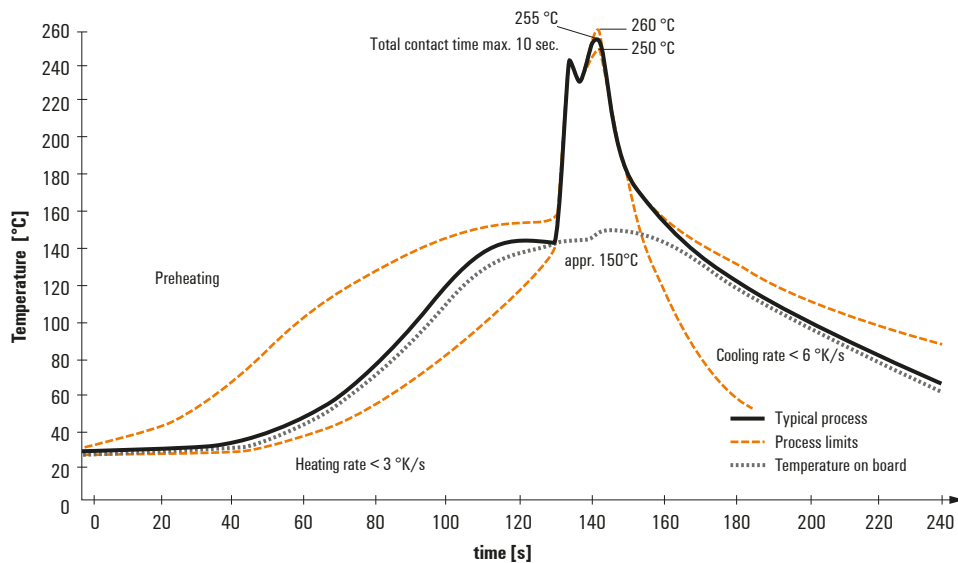
Recommended wave soldering profiles

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Single Wave:



Double Wave:



Wave soldering profiles

Wired connection elements should be processed in accordance with the DIN EN 61760-1 standard. We have included two recommendations for practical wave soldering profiles, with which Weidmüller PCB terminals and connectors are qualified.

When choosing a suitable profile for your application, the following factors also need to be considered:

- PCB thickness
- Proportion of Cu in the layers
- Single/double-sided assembly
- Product range
- Heating and cooling rates

The single and double wave profiles each indicate the recommended operating range, including the maximum soldering temperature of 260 °C . In practice, the maximum soldering temperature is quite often well below the above maximum profile.

We reserve the right to make technical changes.

Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

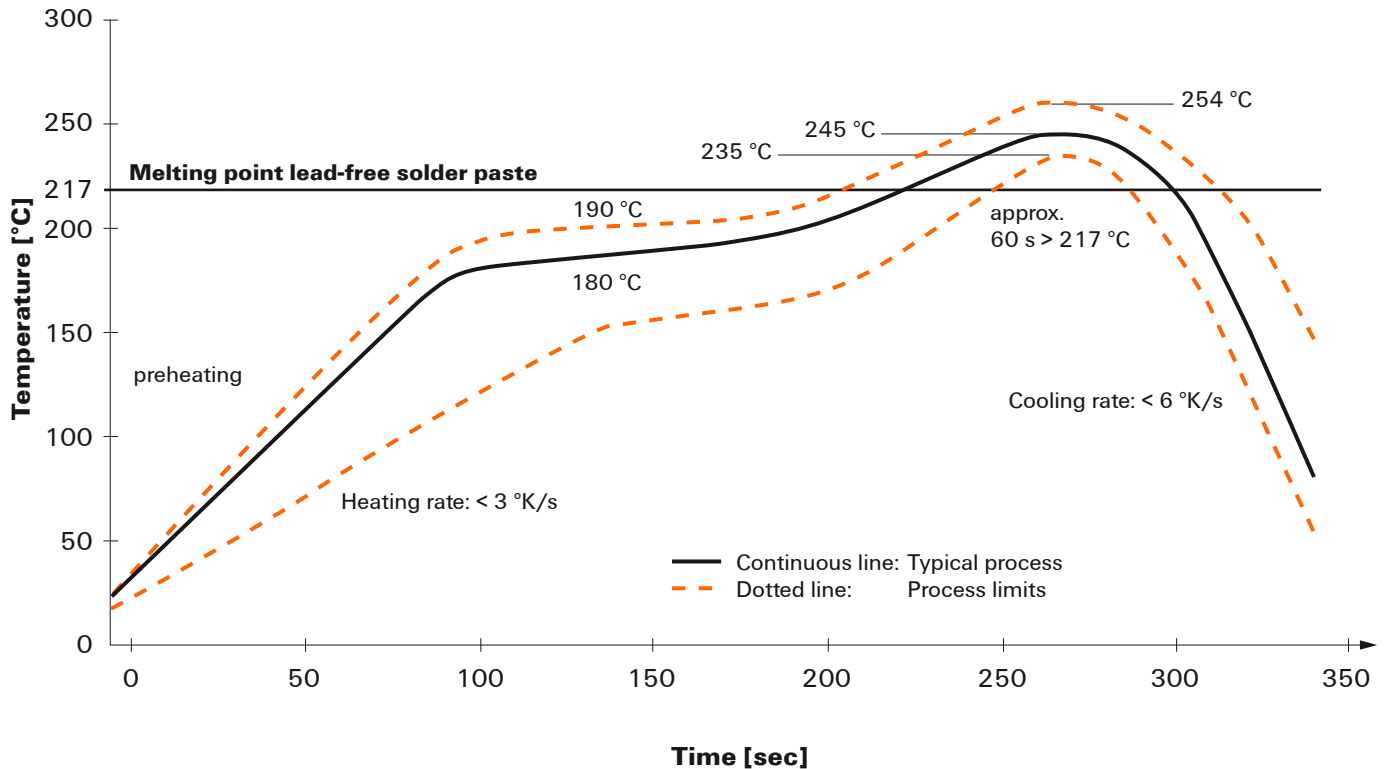
D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.